

**光大证券股份有限公司**

**关于上海季丰电子股份有限公司  
首次公开发行股票并在创业板上市**

**之**

**上市保荐书**

保荐人（主承销商）



**光大证券股份有限公司**  
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.

二〇二六年六月

## 保荐人及保荐代表人声明

光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人朱喆、谈钟灵根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海季丰电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。

## 一、发行人基本情况

### （一）发行人基本信息

公司名称	上海季丰电子股份有限公司
英文名称	Giga Force Electronics Co.,Ltd.
注册资本	11,558.60 万元
法定代表人	郑朝晖
成立日期	2008 年 7 月 7 日
整体变更日期	2016 年 8 月 22 日
住所	上海市闵行区友东路 258-288 号 2 幢 101 室
邮政编码	201199
电话	021-64205085
传真	021-64205085
互联网网址	giga-force.com
电子信箱	IR@giga-force.com
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；计量技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
其他信息	负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室 负责人：邵文宗 电话号码：021-64205085

### （二）发行人主营业务

公司是一家半导体领域检测服务与检测硬件产品的全功能、一站式解决方案提供商，围绕芯片设计、晶圆制造、封装等半导体全产业链企业的检测需求，提供第三方实验室检测分析服务、检测硬件产品、量产业务（量产测试及电子制造服务）、工程样品封装及其他业务。

### （三）发行人核心技术、研发水平

#### 1、发行人的核心技术

报告期内，公司研发体系完善，具有独立自主的研发能力，核心技术均为自

主研发。

公司在为客户提供服务及持续研发创新的过程中，形成了覆盖样品制备、高端线路修补、失效定位、材料分析、测试板设计仿真、量产老化测试等关键环节的完整技术体系，并形成了一批具备先进性的核心技术，包括先进制程逻辑单元立体结构分析方法、先进封装热失效深度定位技术、集成电路测试板设计与仿真技术等。

## 2、发行人的研发水平

### （1）基本情况

公司具备较高的研发水平，已经形成了多项具备市场竞争力的能力：在先进制程检测能力方面，公司的先进制程案例已覆盖 3nm 芯片，设备最先进检测能力可达到 2nm 及以下芯片，处于行业前列；在可靠性测试方面，公司具备单芯片 800W 功率的整体方案能力，在关键技术指标与方案落地能力上处于行业较高水平；在高端线路修补方面，公司配备了红外热像仪支持背开模式、GDS 自动导航定位软件，更适配于先进制程产品的线路修补，可实现精准修改高阶制程芯片的设计缺陷、验证电路设计。

公司的研发活动具备高度的市场导向，是驱动公司核心业务收入持续增长的关键引擎。在日常服务中，公司敏锐捕捉客户在试产与量产环节不断升级的需求，通过持续研发投入形成技术壁垒，并构建了“直接技术变现”与“内部业务赋能”相结合的研发驱动模式，具体体现在以下方面：

①检测分析方法的持续攻坚：公司依托检测分析实验室，重点针对先进制程开发新型分析方法，持续为客户工艺研发提供材料分析，并为客户良率提升提供失效分析，检测分析方法的研发创新直接带动检测服务收入的增长。

②硬件测试板级方案的迭代：公司紧跟芯片高功率化、高复杂度的演进，自主开发高端集成电路测试板及新型板级测试方案，通过硬件产品的交付直接转化为销售收入。

③紧缺测试设备的自主研发与对内赋能：公司针对国内紧缺的工艺可靠性测试设备、高功耗寿命测试设备等核心装备开展自主研发，并率先实现内部使用。这不仅降低了公司对外部设备的依赖，还提升了公司实验室检测分析与量产测试

的产能与服务广度，从而转化为更具规模的测试服务收入；同时，自研设备在内部高强度使用场景中的反馈迭代，也为公司未来探索设备商业化对外销售、从而形成独立收入来源准备了坚实基础。

依托上述研发布局，公司实现了对先进工艺、高端特色工艺及先进封装等高端样品的全方位覆盖，确保研发成果能够切实转化为公司的业务护城河与稳健的财务回报。

## （2）研发投入情况

公司建立了完善的研发流程，保障研发项目的高效顺利执行，能够满足公司发展和市场需求。报告期内，公司研发费用金额分别为 4,405.52 万元、4,962.52 万元和 5,506.10 万元，占营业收入的比例分别为 9.94%、8.51% 和 8.22%。

## （3）合作研发情况

在坚持自主研发创新的基础上，公司积极推动与国内高等院校的合作，进行新型产品研发和重难点技术的攻克，进一步提升了公司研发的理论基础和技术水平。

报告期内，公司与上海交通大学合作研发“超景深三维数字显微仪器研制”项目。该项目围绕半导体失效分析与精密检测需求，开展超景深光学显微镜研发。该项目依托公司在半导体第三方检测领域的应用场景和工艺理解，以及上海交通大学在光学成像、精密仪器设计等方面的技术积累，面向芯片封装结构复杂、元器件尺寸微小、样品表面起伏较大等特点，对光学系统、成像算法和样品运动控制等关键环节进行联合攻关，旨在实现较大景深范围内的高分辨率成像能力，提升对芯片表面缺陷、封装结构和异物颗粒的检测效率和判断准确性，为公司在相关检测细分领域的技术储备和服务能力提供支持。具体内容如下：

合作单位	上海交通大学
合作项目	超景深三维数字显微仪器研制
合作期限	2021.11.1 签订合同，2024.12.17 项目通过阶段性验收
合同金额	647.00 万元
公司义务	提供项目技术背景资料及技术核心参数设计需求等，以派驻人员的方式，完成系统机械、嵌入式软硬件系统及上位机软件的相关研制工作，开展项目进展检查及阶段验收，支付研究开发经费和报酬
合作方义务	交付研究开发计划，负责仪器光学结构、融合算法及样机的研制，按进度

合作单位	上海交通大学
	完成研究开发内容并交付研究开发成果，为公司指定的人员提供技术指导和培训或提供与使用该技术开发成果相关的技术服务
研发成果归属	合作开发过程中所产生的技术开发成果及其知识产权（包括专利及非专利）产生的收益归季丰电子所有
保密措施	双方对涉及的业务、研究、产品、软件、服务、市场、客户、财务、技术以及法律事务等保密信息依法保密并承担泄密责任

#### （四）发行人主要经营和财务数据及指标

报告期内，发行人主要经营和财务数据及指标如下：

项目	2025.12.31/2025 年	2024.12.31/2024 年	2023.12.31/2023 年
资产总额（万元）	172,698.54	154,312.62	133,033.30
归属于母公司所有者权益（万元）	89,472.96	79,650.10	73,490.44
资产负债率（母公司）（%）	46.08	40.91	37.40
营业收入（万元）	66,949.34	58,348.29	44,336.65
净利润（万元）	9,125.55	5,437.55	2,045.41
归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,125.55	5,437.55	2,338.67
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	7,356.84	3,836.86	1,812.95
基本每股收益（元）	0.79	0.47	0.21
稀释每股收益（元）	0.79	0.47	0.21
加权平均净资产收益率（%）	10.80	7.10	3.53
经营活动产生的现金流量净额（万元）	27,924.06	18,171.91	19,527.00
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例（%）	8.22	8.51	9.94

#### （五）发行人存在的主要风险

##### 1、与发行人相关的风险

##### （1）客户需求波动的风险

公司是一家半导体领域检测服务与检测硬件产品的全功能、一站式解决方案提供商，围绕芯片设计、晶圆制造、封装测试等半导体全产业链企业的检测需求，提供第三方实验室检测分析服务、检测硬件产品以及量产测试服务。公司的客户群主要包括芯片设计企业、晶圆代工企业、封装测试企业等，该类客户对第三方

实验室检测的需求与其自身的研发投入力度、研发项目周期、工艺升级等因素高度相关。如未来半导体行业景气度下滑，或工艺迭代进度放缓，则公司客户需求可能出现不利变动。

同时，若下游客户在资金充裕的情况下，为保障核心技术数据安全或出于自身战略布局考虑而选择自建实验室，则其对第三方检测机构的业务需求可能出现下降，导致外部采购减少，进而对公司第三方实验室业务的客户基础与市场空间产生不利影响。

## **(2) 技术泄密的风险**

公司目前已在第三方实验室检测分析服务、集成电路测试板产品及量产测试服务等方面形成了一系列核心技术，该类技术系公司通过多年自主研发结合海量服务案例积累形成。公司现有的主营业务收入主要来源于利用自身核心技术提供的服务和产品销售，因此核心技术的保密对公司现有及未来的经营至关重要。

目前，公司内部已制定一系列技术保密制度，并与特定员工签署保密协议，防范技术泄密风险。但若未来公司技术出现泄密的情况，公司的竞争优势及市场地位将受到影响，进而影响公司的经营业绩及盈利水平。

## **(3) 检测分析仪器依赖进口的风险**

半导体检测分析业务具有技术要求高、精度要求高、响应速度要求高的特点，中国大陆分析仪器行业起步较晚，特别是半导体行业的分析仪器市场基本为境外厂商垄断，造成了国内半导体检测分析厂商的分析仪器普遍依赖进口的现状。

公司与全球多家知名分析仪器商建立了良好稳定的合作关系，但若未来国际贸易环境发生重大不利变化，导致公司无法进口特定厂商的仪器，同时短期内无替代供应商可提供符合需求的分析仪器，则将对公司生产经营产生不利影响。此外，如因国际贸易政策变化等原因，某些供应商对进口分析仪器的使用进行额外的限制，则将对公司业务开展造成不利影响。

## **(4) 经营业绩及毛利率、净利率下降的风险**

报告期内，在半导体国产化趋势深化的大环境和国家科技重大专项与产业投资基金的支持下，我国半导体产业链不断完善，国内已陆续涌现一大批优秀的芯

片设计、芯片制造及封测厂商。而半导体行业技术的更新迭代促进业内厂商大规模开展研发项目，随着半导体工艺复杂度的提升、工艺节点的拓展，对失效分析、材料分析等第三方检测分析与集成电路测试板等检测硬件的需求增长。行业规模的迅速增长也带动公司经营业绩持续上升。

如果未来公司无法持续提升技术实力、服务质量以及客户拓展能力以应对市场竞争，则可能导致公司的订单量或服务价格下降，进而面临毛利率及净利率下滑、净利润无法持续快速增长的风险。

#### **(5) 固定资产规模较大的风险**

半导体检测业务的高效开展高度依赖检测分析仪器的精准性和完备性，报告期内随着业务规模的扩大，公司固定资产规模也逐步攀升。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 58,378.45 万元、73,408.28 万元以及 86,757.94 万元。目前，发行人部分实验室的产能利用率仍存在一定提升空间，若未来无法通过有效导入客户等方式进一步提高产能利用率，将可能制约公司业绩的持续释放。同时，如果未来客户需求、市场竞争环境等发生不利变化导致业务发展速度低于预期，可能导致新增收入与利润无法覆盖新增资产带来的折旧摊销等成本费用，进而影响公司未来净利润水平。

#### **(6) 应收账款无法收回的风险**

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 11,433.51 万元、18,069.11 万元以及 14,305.01 万元，占期末流动资产比例分别为 24.85%、37.06%以及 30.51%。随着公司业务规模的日益扩大，未来应收账款可能存在进一步增长的趋势。应收账款的按期收回对公司营运资金的健康周转至关重要。若未来下游行业或客户经营状况发生重大不利变化，将加大公司应收账款的回收风险，进而对公司的财务状况产生重大不利影响。

#### **(7) 量产测试及电子制造服务业务尚未盈利的风险**

基于在半导体检测分析服务及检测硬件产品领域积累的技术能力与客户资源，公司于 2022 年拓展了量产测试业务，重点布局前景广阔、技术壁垒较高的车规级芯片量产测试市场。尽管目前已经积累了蔚来汽车、禾赛科技等优质客户，并且该业务收入在报告期内逐年增长，但由于测试厂投入较大且客户处于导入期，

量产测试业务目前尚未实现盈利。考虑到量产测试要具备市场竞争力仍需持续进行设备投入，若未来公司的客户导入与订单获取不及预期，公司可能面临因该业务亏损而拖累整体业绩的风险。

随着终端应用对集成度与可靠性要求的不断提高，芯片设计公司正从单一芯片向模组化、系统化方向延伸。为顺应这一行业趋势，公司在原服务于内部集成电路测试板业务而布局的表面贴装线基础之上，于 2025 年新设浙江嘉善产线规模化投入电子制造服务业务，现已取得车规级等质量体系认证。截至 2025 年 12 月 31 日，电子制造服务业务已投入设备原值超过 4,000 万元，但客户尚处于前期导入阶段，该业务目前处于亏损状态，2025 年电子制造服务业务产生的毛利为-1,206.74 万元，预计未来一段时间内仍将对公司整体盈利水平构成压力。

### **(8) 质量控制和声誉风险**

公司作为半导体领域第三方检测服务及检测硬件产品提供商，业务的开展高度依赖于客户对公司中立性、保密性及产品质量的信任。

在第三方实验室业务方面，公司日常经营中涉及客户芯片设计、晶圆制造等核心环节的敏感技术信息。若公司信息安全管理出现疏漏，导致客户核心技术数据发生泄露，或在检测分析过程中未能保持客观中立的第三方立场，将直接损害公司的专业公信力，可能导致核心客户流失，并对公司行业声誉造成长期不利影响。在集成电路测试板等检测硬件产品方面，若公司产品质量管控体系运行失效，导致产品出现设计缺陷、工艺瑕疵或可靠性不达标等质量问题，可能引发客户投诉、退货甚至索赔，进而影响公司与下游客户的长期合作关系。

上述质量与声誉相关风险一旦发生，将严重削弱公司在半导体检测领域的市场信任度，对公司业务拓展、客户维系及经营业绩产生重大不利影响。

## **2、与行业相关的风险**

### **(1) 宏观经济及半导体产业波动的风险**

公司主营业务为半导体领域的检测服务与检测硬件产品，其下游需求与宏观经济形势、半导体产业发展状况密切相关。

半导体产业作为现代信息技术的基础，具有周期性波动的特征，受全球宏观

经济、国际贸易环境、下游终端市场需求等多重因素影响。近年来，随着人工智能、物联网、汽车电子等新兴领域的快速发展，半导体市场需求持续增长，但若未来全球经济增长放缓、国际贸易争端加剧，或消费电子、工业控制等下游应用领域需求出现萎缩，可能导致半导体产业链整体进入下行周期。

公司客户主要包括芯片设计企业、晶圆代工企业、封装测试企业等，该类客户对第三方检测分析及集成电路测试板产品的需求与其自身的研发投入力度、研发项目周期、工艺升级进度等因素高度相关。若半导体行业景气度下滑，下游客户可能缩减研发预算、放缓新品推出节奏或推迟工艺升级，从而减少对第三方检测服务和检测硬件产品的采购需求。

此外，半导体产业的区域发展政策、技术迭代速度、产业链转移趋势等亦将对公司业务产生重要影响。如未来国家对半导体产业的支持力度减弱，或本土产业链发展不及预期，可能导致公司所处市场空间收窄，进而对公司经营业绩和持续发展造成不利影响。

## **(2) 市场竞争风险**

近年来半导体产业快速发展，半导体检测与分析需求快速增加，吸引越来越多的市场参与者积极开展相关领域的投资，争夺市场份额。半导体第三方实验室市场总体呈现市场参与者较多、集中度低的特点，除闾康、发行人、苏试宜特、胜科纳米等头部企业外，行业内还有较多聚焦本地服务的中小型民营半导体第三方实验室。在集成电路测试板领域，公司不仅面临精测、雍智科技等境外厂商的竞争，也面临境内同行业企业的竞争，整体竞争较为激烈。此外，伴随行业的高速发展，未来可能吸引更多新的进入者参与市场竞争。

随着市场竞争程度的提升，无论是第三方实验室检测分析服务还是集成电路测试板产品，均可能面临一定的单价下滑风险，进而对公司盈利能力造成不利影响。同时，未来公司如不能紧跟下游半导体产业技术发展趋势、加大研发投入、提高技术能力与服务水平、加强市场开拓力度、进一步扩大业务规模，将可能无法保持现有的市场竞争力以应对较为激烈的市场竞争，可能会出现客户流失、技术能力下滑、市场份额下降等不利情形，对持续经营产生不利影响。

### **(3) 产业政策变化的风险**

公司目前所从事的半导体领域检测服务与检测硬件产品，其下游需求与国家对于半导体产业的整体政策导向及扶持力度密切相关。近年来，为促进本土半导体产业链的发展，国家相关部门出台了一系列鼓励政策，为公司及下游客户营造了良好的发展环境。若未来相关产业政策发生重大不利调整，或国家对半导体产业的支持力度减弱，可能导致下游芯片设计、晶圆制造、封装测试等企业的扩产计划与研发投入放缓，从而抑制其对第三方实验检测分析及测试板等产品的采购需求。市场需求若出现萎缩或增速显著放缓，将可能对公司的经营业绩和持续发展造成不利影响。

### **(4) 人才流失的风险**

公司所从事的半导体检测业务涉及半导体、材料、机械、光学等多学科的交叉应用，具有较高的技术门槛。公司已集聚了一批拥有跨学科背景与丰富行业经验的优秀人才，保障公司业务的正常开展及持续进步。如若未来公司研发技术人员流失，或无法培养或招聘与行业技术进步所适配的人员，将对公司的经营产生不利影响。

## **3、其他风险**

### **(1) 募集资金投资项目风险**

公司本次发行募集资金拟投资于“浦东技术中心项目”“车规级高可靠量产测试服务建设项目”“芯片中试平台工程技术研发项目”及补充流动资金。尽管本次募投项目已综合考虑了市场环境、发展趋势、成本费用等各种因素，但在项目实施管理、产能消化等各方面仍存在不可预见的风险。

#### **①募投项目实施过程中的风险**

本次募集资金投资项目涉及场地建设、设备采购、人员招聘与培训等多个环节，项目建设周期较长，在项目实施过程中可能受到宏观经济形势变化、产业政策调整、工程建设进度等多方面因素的影响。特别是公司部分高端检测分析设备需从境外采购，若国际贸易争端加剧、进口关税政策调整或境外供应商供货周期延长，可能导致设备采购成本上升、交付延迟，进而影响募投项目的整体建设进度和投资回报。

## ②募投项目产能消化不及预期及预期效益无法实现的风险

本次募投项目建成后，公司将新增第三方实验室检测服务能力、车规级芯片量产测试产能。尽管半导体检测市场需求持续增长，但若未来半导体行业景气度下行、下游客户研发投入放缓，或市场竞争加剧，公司可能面临新增产能无法及时消化的情形。若募投项目实施后，相关服务价格出现下滑、产能未能充分消化、成本出现上升等不利变化，则存在募集资金投资项目预期效益无法实现的风险。

## ③短期内净资产收益率和每股收益摊薄的风险

本次募集资金投资项目全部建成后，公司将新增大量固定资产及无形资产。项目达产后，预计每年新增折旧金额及摊销金额将有较大幅度增加。若募投项目建成后未能按预期实现效益，或市场环境发生不利变化导致项目收益不及预期，新增的折旧摊销费用将直接侵蚀公司利润，可能导致公司经营业绩出现下滑。本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的股本总数、净资产规模将在短时间内大幅增长，而募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部购建完成后才能逐步达到预期收益水平，因此，公司短期内存在净资产收益率和每股收益被摊薄的风险。

## （2）股价波动的风险

二级市场股票价格不仅取决于公司经营状况，同时也受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济形势及投资者心理预期等因素的影响，导致股价波动的原因较为复杂。本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

## （3）发行失败的风险

本次发行上市相关文件须经过深圳证券交易所审核，并报送中国证监会履行注册程序。本次发行能否通过交易所的审核并取得中国证监会予以注册决定存在不确定性。本次发行结果会受到届时市场环境、投资者偏好、价值判断、市场供需等多方面因素的综合影响，若上述因素出现不利变动，本次发行存在因发行认购不足而导致发行失败的风险。

## 二、发行人本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数及占发行后总股本的比例	本次拟公开发行股票不超过 3,852.87 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%
股东公开发售股份数量	不适用
每股发行价格	【】元
发行方式	采取网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立创业板 A 股股票账户的符合条件的境内自然人、法人等其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销

## 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员

### （一）本次证券发行上市的保荐代表人

光大证券指定朱喆、谈钟灵作为本次证券发行上市项目的保荐代表人。

朱喆先生，保荐代表人，2017 年起从事投资银行业务，主要负责及参与的项目包括：佳华科技（688051.SH）、华洋赛车（920058.BJ）等 IPO 项目，富通信息（000836.SZ）等再融资项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。

谈钟灵女士，保荐代表人，2015 年起从事投资银行业务，主要负责及参与的项目包括：阿科力（603722.SH）、佰奥智能（300836.SZ）、炜冈科技（001256.SZ）、华海诚科（688535.SH）等 IPO 项目，凤形股份（002760.SZ）、怡达股份（300721.SZ）等再融资项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。

### （二）本次证券发行上市的协办人及项目组其他成员

光大证券指定肖权作为本次证券发行上市项目的协办人，其保荐业务执业情况如下：

肖权先生，具有保荐代表人资格，2021 年起从事投资银行业务，主要负责及参与的项目包括：翔腾新材（001373.SZ）、盛景微（603375.SH）等 IPO 项目，

永兴材料（002756.SZ）等再融资项目，海天股份（603759.SH）重大资产购买项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。

项目组其他成员包括刘丽敏、王帅、万国冉、张荣正、王鹏、陈姝婷、王如意。项目组所有人员均在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

### **（三）本次证券发行上市的项目组联系方式**

联系地址：上海市静安区普济路 28 号静安国际中心 A 座 17 楼

联系电话：021-52523216

## **四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明**

### **（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况**

截至本上市保荐书签署日，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其实际控制人、重要关联方股份的情况。

### **（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况**

截至本上市保荐书签署日，发行人或其实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

### **（三）保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况**

截至本上市保荐书签署日，保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员不存在持有发行人或其实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其实际控制人及重要关联方任职的情况。

#### **（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况**

截至本上市保荐书签署日，保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

#### **（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系**

截至本上市保荐书签署日，保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

### **五、保荐人承诺事项**

（一）保荐人已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，已具备相应的保荐工作底稿支持。保荐人同意推荐发行人首次公开发行股票并上市，并据此出具本上市保荐书。

（二）通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，保荐人承诺如下：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事、高级管理人员在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、

中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会、深圳证券交易所依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他事项。

（三）保荐人承诺，将遵守法律法规和中国证监会及深圳证券交易所对推荐证券上市的规定，自愿接受深圳证券交易所的自律管理。

## **六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序**

### **（一）本次证券发行履行的决策程序**

2026年2月9日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》及其他有关本次证券发行上市相关的议案，并提交发行人2026年第二次临时股东大会审议。

2026年3月20日，发行人召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》及其他有关本次证券发行上市相关的议案。

### **（二）保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为，发行人本次证券发行方案经公司董事会、股东会决议通过，已经履行了必要的程序，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，决策程序合法合规，决议内容合法有效；发行人股东会授权董事会办理本次公开发行人民币普通股股票的相关事宜，授权范围及程序合法有效。发行人本次证券发行申请尚需履行深圳证券交易所和中国证监会的相应程序，有关股票的上市交易尚需经深圳证券交易所同意。

## **七、保荐人对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的专业判断**

保荐机构通过查阅近年来国家及行业相关政策文件、相关行业报告和市场研究资料，了解发行人所在行业的市场情况、竞争格局、未来发展趋势；访谈发行人高级管理人员及核心技术人员，查阅发行人产品手册，查阅核心技术人员简历，查阅发行人研发管理相关制度等文件，了解发行人核心技术情况、在研项目进度；

查阅发行人专利清单、专利证书及所获荣誉资质；查阅会计师事务所出具的《审计报告》等，对发行人是否符合创业板定位要求进行了审慎核查。

### **（一）发行人具备创新、创意、创造特征**

#### **1、公司以独特的一站式服务模式，服务于超过 3,000 家半导体产业链客户**

公司作为国内领先的半导体一站式解决方案提供商，围绕客户需求构建了半导体检测领域“服务+产品”的一站式能力。该模式实现了客户问题、检测结果、硬件适配与测试反馈的高效衔接，能够提供跨环节诊断与工程化解决方案，缩短问题定位与验证周期，提升芯片研发验证效率及产业化导入能力；同时，有助于公司持续积累工程经验、失效案例与测试数据，增强对复杂芯片研发验证及量产导入的支撑能力。同时，基于在检测分析及硬件产品领域积累的客户资源与技术能力，公司将业务从“0-1”延伸至规模量产阶段，形成双轮驱动模式，拓展了公司的发展空间。

此外，公司具备软件设计及硬件开发的双重能力，通过开发定制化仪器设备为实验室赋能，使实验室形成了独特的服务能力与方案解决能力。公司的定制化仪器设备包括手动探针台、芯片软失效分析系统（SER）、射频信号源（RF-Source）及射频功率放大器（RF-PA）、阻抗测试仪（AMR）、SoC 老化测试机（H160、F370）、三维超景深显微镜、电源管理及监控系统、LIMS（实验室信息管理系统）等。

凭借全功能、一站式模式及优秀的技术实力与服务品质，公司已为半导体产业链超 3,000 家客户提供服务。

#### **2、公司拥有较强的技术创新能力，已形成具备先进性的核心技术**

发行人在失效分析、材料分析、可靠性分析及集成电路测试板等业务形成了一系列核心技术，例如先进制程逻辑单元立体结构分析方法、先进封装热失效深度定位技术、集成电路测试板设计与仿真技术等。公司技术体系覆盖样品制备、高端线路修补、失效定位、材料成分分析、集成电路测试板设计及仿真、量产老化测试等多个关键环节，能够从单点检测能力向系统级工程验证能力延伸，体现出较强的技术集成能力和工程化服务能力。发行人技术路线符合国际半导体检测分析向先进制程、先进封装和多物理场分析演进的方向。

以公司的核心技术之一先进制程逻辑单元立体结构分析技术为例，该技术主要应用于半导体检测分析领域中技术含量最高的方向之一——先进制程芯片失效分析，具备国内先进水平和较强的产业链支撑价值。该技术整合了微光电镜电信号分析手段、纳米探针探测技术、聚焦离子束精确定位制样、透射电镜原子级成像与多物理信号关联解析，构建了跨尺度形貌—成分—结构协同解析的方法体系。随着器件从平面 MOSFET 向 FinFET、GAA 等三维结构演进，芯片缺陷不再只是单点物理缺陷，而与设计、工艺、材料、应力、电性等多因素耦合相关，分析需从“找缺陷”转向“解释失效机理”。该技术所构建的跨尺度协同解析方法，恰好契合了这一深层分析需求，其应用可为先进制程芯片的良率改善提供有力支持。

### 3、公司知识产权丰富，检测资质和质量体系完善，具备技术自主可控能力

截至本上市保荐书签署日，公司及子公司累计拥有专利 135 项，其中发明专利 53 项。公司拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的 145 个检测项目、检验检测机构资质认定（CMA）的 60 个检测项目，并获得 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO/IEC17025 国际实验室管理体系认证、IATF16949 汽车工业质量管理体系认证、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证等。

## （二）发行人符合创业板定位相关指标要求

公司符合《申报及推荐暂行规定》第四条第（二）项创业板定位相关指标要求，具体情况如下：

创业板定位相关指标二	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	是	公司高度重视研发投入，2023 年-2025 年研发投入合计 14,874.14 万元，最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元。
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%，最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求	是	公司 2025 年营业收入为 6.69 亿元，超过 3 亿元，可不适用营业收入复合增长率要求。

## （三）发行人具有较强的成长性

受益于半导体产业国产化与技术进步的双重机遇，发行人业务规模稳步增长，

2023年、2024年及2025年，发行人营业收入分别为44,336.65万元、58,348.29万元及66,949.34万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1,812.95万元、3,836.86万元及7,356.84万元，整体表现出较强的成长性。

在国际贸易争端背景之下，发展半导体产业已上升至国家战略层面，随着高端芯片国产化进程加速，人工智能、汽车电子等高可靠性应用对芯片指标提出更为严苛的标准，先进制程、先进封装等半导体技术更新迭代，半导体产业链企业对第三方实验室检测分析、集成电路测试板等检测硬件产品以及量产测试服务的需求预计将保持快速增长。发行人凭借全功能、一站式服务模式，优秀的检测分析服务能力、检测硬件设计能力与量产测试能力，完善的区域布点、庞大的客户基数以及优质的客户服务品质等竞争优势，有望充分受益于行业增长的红利，持续提升市场份额与经营业绩。

#### **（四）发行人业务符合国家产业政策**

发行人围绕芯片设计、晶圆制造、封装测试等半导体全产业链企业在研发验证、工艺优化、可靠性评价、质量控制和量产导入等环节的检测需求，提供第三方实验室检测分析服务、检测硬件产品以及量产测试服务。公司主要服务集成电路产业链，公司核心业务属于集成电路产业链关键技术攻关、工程化验证和质量可靠性保障的重要配套环节，对我国半导体产业实现技术演进、工艺进步、质量提升，进而实现自主发展有积极作用。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司核心业务均属于战略性新兴产业。其中第三方实验室检测分析服务对应“1 新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.4 新型信息技术服务”之“国民经济行业代码 6560\*信息技术咨询服务”之“测试评估认证服务”；检测硬件产品对应“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，集成电路相关的“先进封装与测试”“集成电路装备及关键零部件”属于鼓励发展类条目。

从国家战略布局来看，集成电路产业是信息产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性、先导性产业。《中共中央关于制定国

国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，加强原始创新和关键核心技术攻关，采取超常规措施，全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。同时，提出推动科技创新和产业创新深度融合，布局建设概念验证、中试验证平台，加大应用场景建设和开放力度。公司业务与“十五五”时期全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关的政策方向一致，符合国家产业政策和经济发展战略。

综上，保荐机构认为，发行人核心业务属于战略性新兴产业，符合产业政策和国家经济发展战略，发行人具备较强的创新性、成长性，符合《首次公开发行股票注册管理办法》《申报及推荐暂行规定》等法律、法规或规范性文件对创业板定位的要求。

## 八、保荐人对发行人是否符合上市条件的说明

保荐人对发行人是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件进行了尽职调查和审慎核查，核查结果如下：

（一）发行人符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件。

（二）本次发行前发行人股本总额为人民币 11,558.60 万元，本次发行后发行人股本总额为人民币 15,411.47 万元，发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元。

（三）发行人本次拟公开发行股份 3,852.87 万股，公开发行的股份占发行后公司股份总数的 25%，公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上。

（四）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条中所规定的具体上市标准包括：“发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：（一）最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元；（二）预计市值不低于 15 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 4 亿元；（三）预计市值不低于 50 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿元；（四）预计市值不低于 30 亿元，最近一年营业收入不低于 2 亿元，最近三年营业收入复合增长率不低于 30%；或者预计市值不低于 40 亿元，最近一年营业收入不低于 2 亿元，最近三年累计研发投入不低于 1 亿元且占最近三年累计营业收入的比例不低于 15%。”

根据发行人现行有效的《公司章程》，发行人为境内企业且不存在表决权差异安排。根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕11158号），发行人2025年度经审计的营业收入为66,949.34万元，扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润为7,356.84万元，公司最近一年净利润为正且营业收入不低于4亿元。结合发行人最近一次增资对应的估值情况以及参考公司2025年度经营业绩及行业平均市盈率对公司市场价值的预估结果，预计发行人发行后总市值不低于人民币15亿元，满足前述上市标准。

因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2条第（二）项的上市标准，即“预计市值不低于15亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于4亿元”。

（五）发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

## 九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

事项	工作安排
（一）持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导。持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作由本保荐机构继续完成。
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度	督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止大股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人有效执行《公司章程》《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度；督导发行人及时向保荐人通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	督导发行人严格按照《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；在发行人发生需进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性；持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，要求发行人通知保荐人，并督导其履行相关信息披露义务。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人进一步完善和规范为他人提供担保等事项的制度；持续关注发行人为他人提供担保等事项，督导

事项	工作安排
	其履行相关信息披露义务,并对发行人对外担保事项发表意见。
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制,及时获取发行人的相关信息。
8、根据监管规定,在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访,查阅所需的相关材料,并在必要时进行现场检查。
(二) 保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	定期或者不定期对发行人进行回访、查阅保荐工作需要的材料;列席发行人的股东会和董事会;对有关部门关注的发行人相关事项进行核查,必要时可聘请相关证券服务机构配合。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	发行人已在保荐协议中承诺配合保荐人履行保荐职责,及时向保荐人提供与本次保荐事项有关的真实、准确、完整的文件;接受保荐人尽职调查和持续督导的义务,并提供有关资料或进行配合。
(四) 其他安排	无。

## 十、保荐人认为应当说明的其他事项

无其他需要说明的事项。

## 十一、保荐人对发行人本次股票上市的推荐结论

保荐人认为,发行人申请其股票在创业板上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。光大证券同意担任发行人本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市,并承担相关保荐责任。

(此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于上海季丰电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人: 肖权 2026年 6月 9日

保荐代表人: 朱喆 2026年 6月 9日

谈钟灵 2026年 6月 9日

内核负责人: 金温平 2026年 6月 9日

保荐业务负责人: 李振宇 2026年 6月 9日

保荐人法定代表人、总裁: 刘秋明 2026年 6月 9日

保荐人董事长: 赵陵 2026年 6月 9日

保荐人: 光大证券股份有限公司 (公章) 2026年 6月 9日

